



# ヤマナカヒューテック株式会社 全株式取得に関するお知らせ

2024年5月16日

## 半導体構造複雑化を牽引する、Deposition分野への参入

- 先端半導体デバイスにおけるALD材料での採用実績を有するYHCをグループ化
- 半導体材料リーダーへ向けて、製品ポートフォリオにプリカーサーを追加
- 顧客価値への貢献に向けたイノベーション及び技術・品質を重視する共通文化
- YHCの製品開発リソース強化、グローバル販売・技術サポートインフラを提供
- 顧客基盤の拡大と、新規Si系材料・メタル系材料への製品拡大による事業拡張

<b>案件概要</b>	ヤマナカヒューテック株式会社の株式を全株取得し、当社の完全子会社とすることで合意
<b>対象会社</b>	<p>ヤマナカヒューテック株式会社（代表取締役社長：森脇 健）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>半導体材料・光ファイバー材料等の高純度化学薬品の製造販売</li><li>京都府京都市左京区下鴨松原町29</li><li>設立：1967年11月1日</li><li>従業員数：76名（2023年6月現在）</li></ul>
<b>スケジュール</b>	<p>契約締結：2024年5月15日</p> <p>買収実行日：2024年8月（予定）</p>

# ヤマナカヒューテック保有材料

ファイン ケミカル	CVD材料	<ul style="list-style-type: none"><li>Al配線保護膜、層間絶縁膜、Low-K膜・ガスバリア膜</li><li>TEOS/TEPO/TMPO/TEB/HMDS/HMSDO等</li></ul>
	ALD材料	<ul style="list-style-type: none"><li>Si系戦略製品</li></ul>
	拡散材料	<ul style="list-style-type: none"><li>POCl3/BBr3/SiCl4/Ga系材料他</li></ul>
	パワーデバイス用 材料	<ul style="list-style-type: none"><li>Si系戦略製品</li></ul>
	レジスト用材料	<ul style="list-style-type: none"><li>各種MEMSセンサー、インクジェット、医療用デバイス等への受託サービス加工</li></ul>
MEMS		<ul style="list-style-type: none"><li>スプレー用コーティング剤の開発販売</li><li>精密スプレーコートの受託サービス加工</li></ul>
コーティング		<ul style="list-style-type: none"><li>2-12インチサイズのシリコンウエハの各種基板販売及び各種ウエハへの加工</li></ul>
シリコンガラスウエハ		

- Al配線保護膜、層間絶縁膜、Low-K膜・ガスバリア膜
- TEOS/TEPO/TMPO/TEB/HMDS/HMSDO等

- Si系戦略製品

- POCl3/BBr3/SiCl4/Ga系材料他

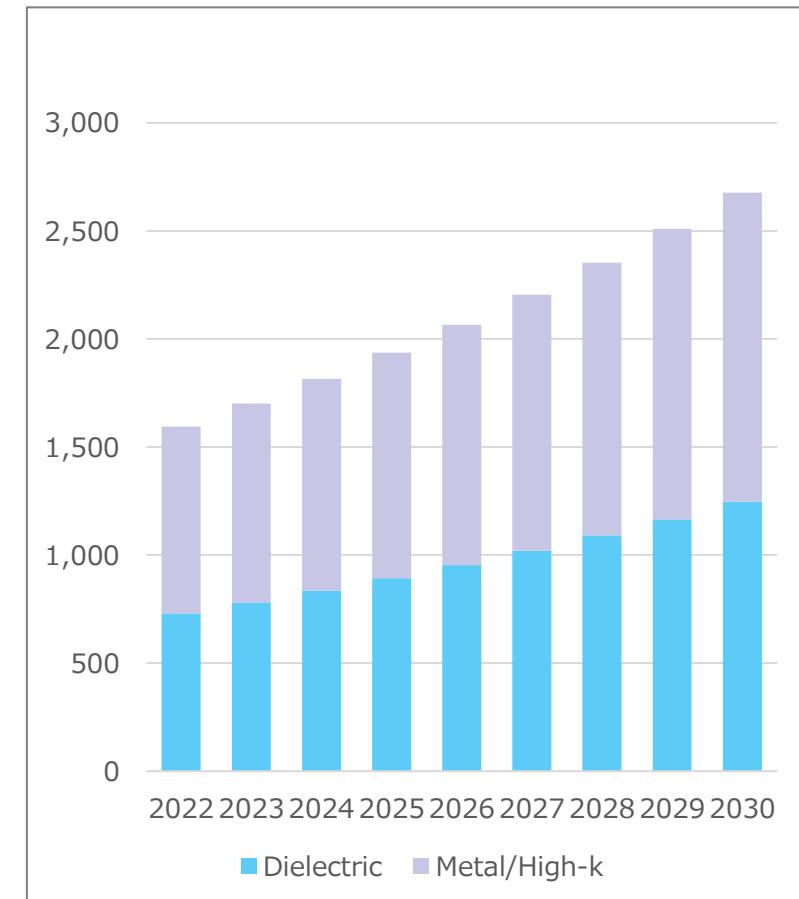
- Si系戦略製品

- 各種MEMSセンサー、インクジェット、医療用デバイス等への受託サービス加工

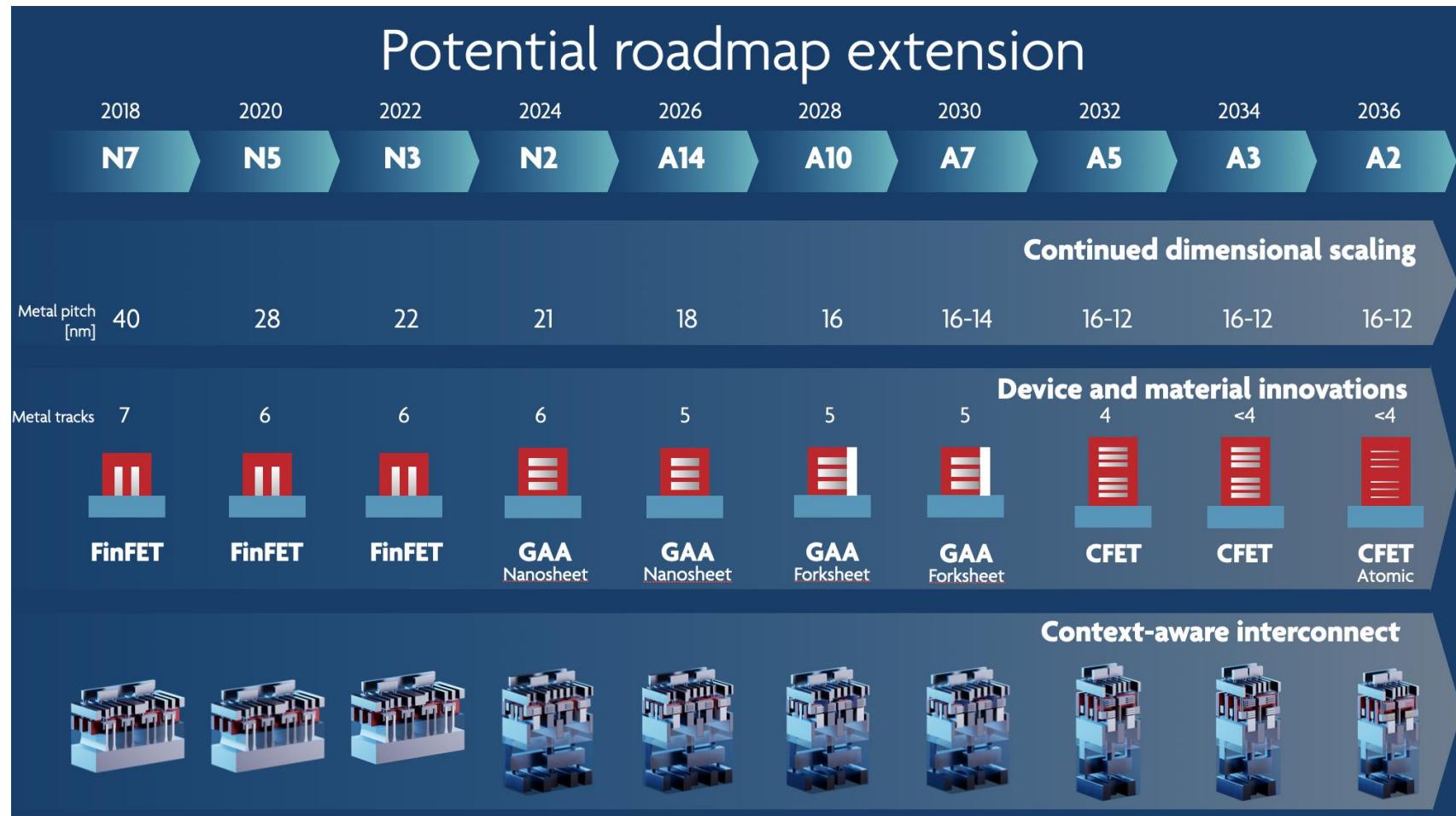
- スプレー用コーティング剤の開発販売
- 精密スプレーコートの受託サービス加工

- 2-12インチサイズのシリコンウエハの各種基板販売及び各種ウエハへの加工

## ご参考) プリカーサー推定市場規模 (MUSD)



# デバイストレンドとキーテクノロジー



## □ 半導体の進化のけん引役

### 1. Scaling

- メタルレジストを含むEUVレジスト、多層材料ラインナップによる微細化への貢献



### 2. Complexity

- 構造複雑化を担う Deposition工程における重要材料であるプリカーサーを当社ポートフォリオに追加



### 3. 3D

- Heterogeneous Integration